

Singulation System

Model LGR1040



Half-cut machine suitable for wettable QFN packages

适用于Wetable QFN封装的Half Cut设备

产品信息



中文

- 可实现无Lead产品（如QFN产品）的高精度刀片切割
- 根据工艺和引线框架的设计，有刀片切割（FMS3040-HC）或激光切割（LGR1040）可供选择
- 将专用引线框架与激光相结合，确保稳定的开槽深度



SPECIFICATION

Items		Unit	Description		
机型		—	LGR1040		
框架尺寸	长度	mm	240—300		
	宽度	mm	74—100		
	厚度	mm	0.6—2.0		
产品尺寸	最小	mm	1×1		
	最大	mm	40×40 (Scan FOV)		
基板翘曲量		—	4mm／300mm (Max.)		
激光		—	1 Head, Single table		
外形尺寸	机类型	module	Loader	Cut Engine	Unloader
	宽度	mm	950	700	850
	纵深	mm	900	1,700	900
	高度	mm	1,700	1,700	1,700
重量		ton	1.5		
框架供给部	类型	—	Slit magazine		
	数量	pcs	4 (Max.) 当弹匣宽度为115毫米时		
产品收纳机构	类型	—	Slit magazine		
	数量	pcs	4 (Max.) 当弹匣宽度为115毫米时		
品种转换件更换时间		min	20		
产品传送方式		—	Vacuum		
产品处理能力		UPH	4,600 at QFN4×4 (672 packages／workpiece)		

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation